

证券代码：688419

证券简称：耐科装备

公告编号：2026-006

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于使用部分结余募集资金投资新项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“耐科装备”）于 2026 年 3 月 20 日召开了 2026 年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金投资建设新项目的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“半导体封装装备新建项目”结余的部分募集资金 4,161.00 万元（含利息及现金管理收益）投资建设“基于先进封装的半导体封装装备制造升级技改项目”（以下简称“新项目”“本项目”），保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

上述事项尚需提交公司股东会审议。股东会审议通过后，公司将开立新项目募集资金存放专用账户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署募集资金专户存储三方监管协议。公司将按照募集资金管理的相关规定及公司《募集资金管理制度》对募集资金和超募资金的使用进行监管，保荐机构将持续按相关法规要求对募集资金管理和使用发表意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207 号文核准，本公司于 2022 年 10 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,500,000.00 股，每股发行价为 37.85 元，应募集资金总额为人民币 77,592.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,459.37 万元后，实际募集资金金额为 70,133.13 万元。该募集资金已于 2022 年 11 月 2 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0300 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、募集资金结余情况

2025年12月5日,公司召开2025年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》,同意公司对“半导体封装装备新建项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”及“先进封装设备研发中心项目”变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金管理。具体内容详见公司于2025年12月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理及使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-035)。

三、新项目具体情况

(一) 新项目基本情况和投资计划

1、项目实施主体:安徽耐科装备科技股份有限公司

2、项目名称:基于先进封装的半导体封装装备制造升级技改项目

3、项目建设地点:安徽耐科装备科技股份有限公司厂区内

4、项目建设内容:本项目不新增用地、不新建建筑,改造安徽耐科装备科技股份有限公司现有半导体封装装备厂房局部,改造建筑面积2000m²。新增生产设备、辅助设备等共计31台(套)。通过技术改造完成后,不新增公司已有半导体封装装备生产产能,原半导体封装装备新建项目年产半导体自动封装设备(含配套模具)80台(套)产能中的20台(套)产能将用于制造先进封装工艺装备,实现年产20台(套)用于先进封装的半导体封装装备的产能。

5、项目投资规模及资金来源:本项目总投资4,161.00万元,其中建设投资3,088.00万元,铺底流动资金1,073.00万元。资金来源为公司首次公开发行股票募集资金投资项目的结余资金。具体投资明细如下:

序号	项目名称	拟投资(万元)	拟使用募集资金投入金额(万元)	占投资比例
1	设备购置费	2,740.00	2,740.00	65.85%
2	安装工程费	137.00	137.00	3.29%

3	工程建设其它费用	151.00	151.00	3.63%
4	预备费用	60.00	60.00	1.44%
5	铺底流动资金	1,073.00	1,073.00	25.79%
合 计		4,161.00	4,161.00	100.0%

6、项目建设的工期

新项目计划开工时间：股东会通过之日起 6 个月内；

建设期限：36 个月；

（二）新项目必要性分析

1、顺应政策导向，抓住市场机遇需要

2025 年发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》中，集成电路被明确列为事关国家安全和全局的核心技术攻关领域。国家提出要“完善新型举国体制”，采取超常规措施，全链条推动集成电路等关键核心技术攻关，实现决定性突破。这为产业的长期发展指明了战略方向。半导体特别是集成电路产业及相关填补国内空白的设备制造产业成为国家鼓励发展的战略性新兴产业，公司若能顺应国家政策导向，抓住由此带来的市场机遇，将有利于公司持续健康发展。

2、满足市场需求，提升半导体封装设备自主化水平，巩固和提升市场地位的需要

我国半导体产业发展较快，半导体功率器件、集成电路及功率模块等不断向高密度、小型化、超宽排、高可靠性方向发展，其生产逐步向先进封装自动化和无人化方向发展，前景广阔。目前，采用转注成型工艺技术封装设备实现了进口替代，但全自动封装设备仍然以进口为主，国产化率不高。而工艺更复杂的压塑成型工艺技术设备，国内工程化应用还处于空白，急需国产化替代。随着先进封装技术的发展，国内对用于先进封装的半导体封装设备国产化的呼声越来越高。随着信息化、智能化技术的发展，先进封装的半导体产品的需求量越来越大，国产化的需求越来越高。我国半导体产品和半导体装备面临一个难得的发展机遇期。

3、提升盈利能力，增强市场竞争力，实现公司长远发展的需要

我国半导体封装设备产业处于快速增长期，具有广阔的市场前景。通过多年的研发投入，公司自主研发的全自动封装设备已得到高度认可，客户规模逐年增

长。本项目的实施有利于公司进一步提升产品种类和技术水平，丰富和优化公司的产品线，增加公司的盈利能力，巩固和提升市场竞争优势，为公司的长远发展奠定坚实的基础。

（三）新项目可行性分析

1、各级政府产业发展政策支持

从国家宏观战略发展规划，到地方省、市各级产业规划，都制定了多项促进政策，进一步优化半导体产业的发展环境，鼓励半导体产业提升创新能力，打破国外垄断，实现跨越式发展，为本项目的顺利实施提供充分的政策支持与保障。

2、用于先进封装的半导体封装装备市场前景广阔，符合公司战略

国际半导体协会（SEMI）发布数据显示，2025年全球半导体原始设备制造商（OEM）设备销售总额为1,330亿美元，同比增长13.7%，创历史新高。2026年、2027年有望继续攀升至1,450亿到1,560亿美元。后端设备领域延续2024年开始的强劲复苏，其中封装设备销售额增长19.6%达到64亿美元，未来两年将保持持续增长。

中国是全球最大的半导体材料和半导体设备消费国。近年来，在政府鼓励和市场需求的三重带动下，尤其在中美贸易、地缘政治影响下，市场对设备国产化的需求更加强烈，半导体封装设备生产企业的生产能力不断增强。以本公司为代表的封装设备企业正抓住国内半导体设备国产化的契机，加大研发和投资，快速发展。本项目的实施，将继续保持企业的技术、质量和市场优势，符合公司的战略发展需要。

3、公司实力雄厚，具备项目实施所需的技术、人才和市场基础

公司为上交所科创板上市企业，资金储备充足，经营现金流良好。经过多年发展，拥有成熟的组织架构、经验丰富的管理和专业技术团队，积累了大量半导体封装设备知识产权和关键技术，拥有包括华天科技、通富微电、长电科技和安世半导体等国内外半导体封装头部企业客户。

四、新项目可能存在的风险

1、新产品研发及市场开拓不及预期的风险

本项目的可行性研究是基于当前国家政策导向、市场发展、技术发展趋势等因素做出的，并进行了研究论证，但若本项目研发的新产品研发成果不及预期，

客户认可度较低或客户验证进度缓慢，亦或是未来市场环境发生较大变化、项目实施过程中发生不可预见因素等导致项目延期或无法实施，可能对公司未来经营业绩的持续提升产生不利影响。

2、净资产收益率下降风险

本次拟使用部分结余募集资金投资建设新项目，存在持续投入的过程，新增人员、折旧及摊销等费用可能将导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营业绩可能产生一定影响。

3、规模扩张导致的管理风险

随着结余募集资金投资新项目的实施，公司业务规模以及人员团队将进一步扩大。将对公司的经营管理、财务内控、质量管理等多方面能力提出更高的要求。公司若后续不能及时完善管理体系及生产管理，提升管理层业务素质及管理水平，将面临因规模扩张导致的经营管理风险。

五、使用结余募集资金建设新项目对公司的影响

公司使用首次公开发行股票募集资金投资项目“半导体封装装备新建项目”结余的部分募集资金投资建设“基于先进封装的半导体封装装备制造升级技改项目”，系根据公司发展战略制定，项目围绕行业发展趋势和市场需求，符合公司业务发展方向，可带动公司针对现有产品进行升级研发。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施后，将对公司未来发展产生积极影响。

六、适用的审议程序及保荐机构核查意见

（一）审议程序

公司于2026年3月20日召开2026年度第二次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用结余募集资金投资建设新项目的议案》，该事项尚需提交股东会审议。

（二）专项意见说明

董事会审计委员会认为：公司本次使用结余募集资金投资建设新项目的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件相关规定，符

合公司主营业务发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意使用结余募集资金投资建设新项目。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次使用部分结余募集资金投资新项目事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定。保荐机构对公司本次使用部分结余募集资金投资新项目事项无异议。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2026年3月21日